

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公開番号】特開2003-6587(P2003-6587A)

【公開日】平成15年1月10日(2003.1.10)

【出願番号】特願2001-184836(P2001-184836)

【国際特許分類第7版】

G 06 K 19/07

B 42 D 15/10

G 06 K 19/077

【F I】

G 06 K 19/00 H

B 42 D 15/10 521

G 06 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月13日(2004.8.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体部品の裏面に該半導体部品の補強を行う第1半導体部品補強部材を接触させて設け、

上記半導体部品及び上記第1半導体部品補強部材が接触した状態にて、当該半導体部品及び第1半導体部品補強部材と第1基材とを相対的に押圧し、上記半導体部品及び上記第1半導体部品補強部材を上記第1基材内へ埋設する、

ことを特徴とする半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項2】

上記埋設動作後、上記裏面に対向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第1基材の回路形成面に、上記電極部に接触して回路パターンを形成する、請求項1記載の半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項3】

半導体部品と第1基材とを相対的に押圧して上記半導体部品を上記第1基材内へ埋設し、

上記半導体部品の補強を行う第1半導体部品補強部材が予め埋設された第2基材を、上記第1基材内に埋設された上記半導体部品の裏面側であって上記半導体部品と上記第1半導体部品補強部材とが重なるように配置し、

上記第1基材と上記第2基材とを接合し、

上記接合後、上記裏面に対向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第1基材の回路形成面に、導電性ペースト又は金属メッキにて上記電極部に接触して回路パターンを形成する、

ことを特徴とする半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項4】

請求項2又は3記載の半導体部品実装済部品の製造方法にて製造されたことを特徴とする半導体部品実装済部品。

【請求項5】

請求項 2 又は 3 記載の半導体部品実装済部品の製造方法にて半導体部品実装済部品を製造し、

上記第 1 基材の厚み方向から第 3 基材及び第 4 基材にて上記半導体部品実装済部品のラミネート処理を行う、

ことを特徴とする半導体部品実装済完成品の製造方法。

【請求項 6】

上記第 1 基材の上記回路形成面側に上記第 4 基材が配置されるとき、上記半導体部品に對向して上記第 4 基材には予め第 2 半導体部品補強部材が埋設されている、請求項 5 記載の半導体部品実装済完成品の製造方法。

【請求項 7】

請求項 5 又は 6 記載の半導体部品実装済完成品の製造方法にて製造されたことを特徴とする半導体部品実装済完成品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

又、上記埋設動作後、上記裏面に對向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第 1 基材の回路形成面に、上記電極部に接触して回路パターンを形成することもできる。